

(19)



JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 11217790 A

(43) Date of publication of application: 10.08.99

(51) Int. Cl

D21H 13/12
D21H 13/26

(21) Application number: 10011483

(22) Date of filing: 23.01.98

(71) Applicant: TORAY IND INC TORAY FINE CHEMICAL KK

(72) Inventor: KAWAKAMI KOJI
AIHARA KIYOSHI
MITSUYOSHI TAKEHIKO
TOMITA TADASHI

(54) PAPER-LIKE SHEET

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a paper-like sheet having a high strength, excellent in heat resistance and further having a low dielectric constant by carrying out papermaking of a specific fluororesin-based fiber in combination with a heat-resistant engineering plastic fiber.

SOLUTION: This paper-like sheet is obtained by subjecting 10-80 wt.%, preferably 40-70 wt.%, more preferably 50-70 wt.% fluororesin-based fiber such as a polytetrafluoroethylene fiber subjected to a

hydrophilization treatment with a fluorine-based surfactant, and having $\leq 90\%$ opening rate in combination with a heat-resistant engineering plastic fiber such as a wholly aromatic polyester fiber, having ≤ 10 g/denier strength and a fiber length shorter than that of the fluororesin-based fiber and within the range of 0.1-10 cm to papermaking. The paper-like sheet has the surface smoothed and compacted by the fusion of the fluororesin-based fiber and also has ≤ 30 cc/cm²/sec air-permeability (JIS L1096). The sheet for a printed circuit board is obtained by laminating at least two sheets of the paper-like sheet.

COPYRIGHT: (C)1999,JPO

- NO POLYESTER-POLYAMIDE FIBERS
- LOW DIELECTRIC CONSTANT
- ELECTRICAL CONDUCTIVITY
- FOR A PC BOARD

(19)



JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **11217790 A**

(43) Date of publication of application: **10.08.99**

(51) Int. Cl

D21H 13/12
D21H 13/26

(21) Application number: **10011483**

(22) Date of filing: **23.01.98**

(71) Applicant: **TORAY IND INC TORAY FINE CHEMICAL KK**

(72) Inventor: **KAWAKAMI KOJI
AIHARA KIYOSHI
MITSUYOSHI TAKEHIKO
TOMITA TADASHI**

(54) PAPER-LIKE SHEET

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a paper-like sheet having a high strength, excellent in heat resistance and further having a low dielectric constant by carrying out papermaking of a specific fluororesin-based fiber in combination with a heat-resistant engineering plastic fiber.

SOLUTION: This paper-like sheet is obtained by subjecting 10-80 wt.%, preferably 40-70 wt.%, more preferably 50-70 wt.% fluororesin-based fiber such as a polytetrafluoroethylene fiber subjected to a

hydrophilization treatment with a fluorine-based surfactant, and having $\leq 90\%$ opening rate in combination with a heat-resistant engineering plastic fiber such as a wholly aromatic polyester fiber, having ≥ 10 g/de strength and a fiber length shorter than that of the fluororesin-based fiber and within the range of 0.1-10 cm to papermaking. The paper-like sheet has the surface smoothed and compacted by the fusion of the fluororesin-based fiber and also has ≤ 30 cc/cm²/sec air-permeability (JIS L1096). The sheet for a printed circuit board is obtained by laminating at least two sheets of the paper-like sheet.

COPYRIGHT: (C)1999,JPO

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-217790

(43)公開日 平成11年(1999)8月10日

(51)Int.Cl.⁶

D 21 H 13/12
13/26

識別記号

F I

D 21 H 5/20

Z
E

審査請求 未請求 請求項の数19 O.L (全 6 頁)

(21)出願番号 特願平10-11483

(22)出願日 平成10年(1998)1月23日

(71)出願人 000003159

東レ株式会社

東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

(71)出願人 000187046

東レ・ファインケミカル株式会社

滋賀県守山市勝部町273番地

(72)発明者 川上 弘二

滋賀県大津市大江1丁目1番1号 東レ株
式会社瀬田工場内

(72)発明者 相原 清

滋賀県大津市大江1丁目1番1号 東レ株
式会社瀬田工場内

(74)代理人 弁理士 香川 幹雄

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 紙状シート

(57)【要約】

【課題】本発明は、強力が高く耐熱性に優れ、プリント配線基板用に樹脂含浸したとしても、その後の誘電率の低いまま維持することができる優れた紙状シートを提供すること。

【解決手段】本発明の紙状シートは、フッ素樹脂系繊維および耐熱性エンジニアリングプラスチック繊維となる紙状シートであって、該シートの表面が該フッ素樹脂系繊維の融着によって平滑緻密化されていることを特徴とするものである。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 フッ素樹脂系繊維および耐熱性エンジニアリングプラスチック繊維とからなる紙状シートであって、該シートの表面が該フッ素樹脂系繊維の融着によって平滑緻密化されていることを特徴とする紙状シート。

【請求項2】 該フッ素樹脂系繊維が、10重量%を越えて80重量%以下の範囲内にある請求項1記載の紙状シート。

【請求項3】 該フッ素樹脂系繊維が、40～70重量%の範囲内にある請求項1または2記載の紙状シート。

【請求項4】 該フッ素樹脂系繊維が、50～70重量%の範囲内にある請求項1または2記載の紙状シート。

【請求項5】 該紙状シートが、 $50 \mu\text{m}$ 以下の厚みを有するものである請求項1～4いずれかに記載の紙状シート。

【請求項6】 該紙状シートが、JIS L-1096の6.27.1-A法により測定した通気度が $30\text{cc}/\text{cm}^2/\text{sec.}$ 以下である請求項1～5いずれかに記載の紙状シート。

【請求項7】 該紙状シートが、 $30\sim100\text{g}/\text{m}^2$ の範囲の目付を有するものである請求項1～6いずれかに記載の紙状シート。

【請求項8】 該紙状シートが、 $30\sim60\text{g}/\text{m}^2$ の範囲の目付を有するものである請求項1～6いずれかに記載の紙状シート。

【請求項9】 該耐熱性エンジニアリングプラスチック繊維が、 $10\text{g}/\text{d}$ 以上の強度を有するものである請求項1～8いずれかに記載の紙状シート。

【請求項10】 該耐熱性エンジニアリングプラスチック繊維が、 $0.1\sim1.5\text{cm}$ の範囲の繊維長を有するものである請求項1～9いずれかに記載の紙状シート。

【請求項11】 該耐熱性エンジニアリングプラスチック繊維が、 $0.1\sim1.0\text{cm}$ の範囲の繊維長を有するものである請求項1～9記載の紙状シート。

【請求項12】 該フッ素樹脂系繊維が、該耐熱性エンジニアリングプラスチック繊維の繊維長より長いものである請求項1～11記載の紙状シート。

【請求項13】 該フッ素樹脂系繊維が、90%以上の開纖率を有するものである請求項1～12のいずれかに記載の紙状シート。

【請求項14】 該フッ素樹脂系繊維が、親水化処理されているものである請求項1～13いずれかに記載の紙状シート。

【請求項15】 該親水化処理が、フッ素系界面活性剤による表面処理である請求項14記載の紙状シート。

【請求項16】 該耐熱性エンジニアリングプラスチック繊維が、全芳香族ポリエステル繊維である請求項1～15いずれかに記載の紙状シート。

【請求項17】 該フッ素樹脂系繊維が、ポリ四フッ化エチレン繊維である請求項1～16のいずれかに記載の紙状シート。

【請求項18】 該紙状シートが、プリント配線基板用シートである請求項1～17のいずれかに記載の紙状シート。

【請求項19】 該紙状シートが、少なくとも二枚からなる積層シートである請求項1～18記載の紙状シート。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、強力が高くて耐熱性に優れ、しかも誘電率の低い紙状シートに関するものである。

【0002】

【従来の技術】近年、誘電率、誘電正接が小さく、高周波特性に優れたプリント配線板としてフッ素樹脂系繊維を用いた抄紙法による湿式不織布（シート）を基材とするものが提案されている。たとえば、特開昭63-69106号公報では、フッ素樹脂系繊維を用いた不織布を基材として用いるものが提案されている。

【0003】また、特開平2-268486号公報では、フッ素樹脂系繊維とエンジニアリングプラスチック繊維とからなる混抄不織布が提案されている。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記特開昭63-69106号公報に記載されたものは、フッ素樹脂系繊維製不織布を基材としても、シートの引張強度が弱く、伸びが大きく腰がなく、張力に耐えられないので、その後の樹脂加工がしにくいという欠点があった。

【0005】一方、特開平2-268486号公報に記載されたフッ素樹脂系繊維とエンジニアリングプラスチック繊維とからなる混抄不織布は、単なる不織布であるためか、引張強度の低いものでしかも、プリント配線板を製造しようとしても、やはり樹脂加工がしにくいという欠点があった。

【0006】本発明は、かかる従来技術の背景に鑑み、強力が高く耐熱性に優れ、プリント配線基板用に樹脂含浸したとしても、その後の誘電率の低いままで維持することができる優れた紙状シートを提供せんとするものである。

【0007】

【課題を解決するための手段】本発明は、かかる課題を解決するために次のような手段を採用する。すなわち、「フッ素樹脂系繊維および耐熱性エンジニアリングプラスチック繊維とからなる紙状シートであって、該シートの表面が該フッ素樹脂系繊維の融着によって平滑緻密化されていることを特徴とする紙状シート。」

「該フッ素樹脂系繊維が、10重量%を越えて80重量%以下の範囲内にある前記紙状シート。」

「該フッ素樹脂系繊維が、40～70重量%の範囲内にある前記いずれかの紙状シート。」

「該フッ素樹脂系纖維が、50～70重量%の範囲内にある紙状シート。」

「該紙状シートが、50μm以下の厚みを有するものである紙状シート。」

「該紙状シートが、JIS L-1096の6.27.1-A法により測定した通気度が30cc/cm²/sec.以下である前記いずれかの紙状シート。」

「該紙状シートが、30～100g/m²の範囲の目付を有するものである前記いずれかの紙状シート。」

「該紙状シートが、30～60g/m²の範囲の目付を有するものである前記いずれかの紙状シート。」

「該耐熱性エンジニアリングプラスチック纖維が、10g/d以上の強度を有するものである前記いずれかの紙状シート。」

「該耐熱性エンジニアリングプラスチック纖維が、0.1～1.5cmの範囲の纖維長を有するものである前記いずれかの紙状シート。」

「該耐熱性エンジニアリングプラスチック纖維が、0.1～1.0cmの範囲の纖維長を有するものである前記いずれかの紙状シート。」

「該フッ素樹脂系纖維が、該耐熱性エンジニアリングプラスチック纖維の纖維長より長いものである前記いずれかの紙状シート。」

「該フッ素樹脂系纖維が、90%以上の開纖率を有するものである前記いずれかの紙状シート。」

「該フッ素樹脂系纖維が、親水化処理されているものである前記いずれかの紙状シート。」

「該親水化処理が、フッ素系界面活性剤による表面処理である紙状シート。」

「該耐熱性エンジニアリングプラスチック纖維が、全芳香族ポリエステル纖維である前記いずれかに記載の紙状シート。」

「該フッ素樹脂系纖維が、ポリ四フッ化エチレン纖維である前記いずれかの紙状シート。」

「該紙状シートが、プリント配線基板用シートである紙状シート。」

「該紙状シートが、少なくとも二枚からなる積層シートである前記いずれかの紙状シート。」

【0008】

【発明の実施の形態】本発明は、プリント配線基板用に樹脂含浸した後でも、誘電率の低さをそのまま維持することができる紙状シートを提供できないか鋭意検討したところ、フッ素樹脂系纖維と耐熱性エンジニアリングプラスチック纖維という特定な組合せで、しかも抄紙という手段でシート化したものが、纖維の均一分散性に優れた均質な紙状シートを提供することを発明したものである。さらに、プリント性、絵際の鮮明性に優れたものを提供するために、平滑化処理したところ、意外にも強力が高く、かつ、耐熱性にも優れた紙状シートを実現することができることを発明したものである。

【0009】本発明の紙状シートは、フッ素樹脂系纖維と耐熱性エンジニアリングプラスチック纖維とからなる。ここで、フッ素樹脂系纖維としては、ポリ四フッ化エチレン（以下、PTFEという）、四フッ化エチレン／エチレン共重合体、四フッ化エチレン／パーフルオロアルコキシエチレン共重合体、四フッ化エチレン／6フッ化プロピレン／パーフルオロアルコキシエチレン共重合体、三フッ化塩化エチレン樹脂、三フッ化塩化エチレン／エチレン共重合体、フッ化ビニル樹脂、フッ化ビニリデン樹脂などを使用することができるが、特に誘電率の低いPTFE好ましく使用される。

【0010】フッ素樹脂系纖維は、引張強度の高い紙状シートを得るために、纖維長が0.1～1.0cmの範囲のものを使用するのが好ましい。

【0011】かかるフッ素樹脂系纖維は、そのままで使用することができるが、引張強度の高い紙状シートを得るために、抄紙工程での纖維の分散性を上げることが望まれる。そのためには、フッ素樹脂系纖維の開纖率を、好ましくは90%以上、さらに好ましくは95～100%とする。ここでいう開纖率とは、1.0cmにカットした100本の纖維をマイクロスコープで観察することにより、次の計算式で求められる値である。すなわち、開纖率(%) = { (A-B) / A } × 100

式中、A：糸本数、B：2本以上の単纖維からなる糸本数を示す。

【0012】また、フッ素樹脂系纖維は、湿式不織布化工程での分散性をさらに向上させるためには、プラズマ処理するか、または、フッ素系界面活性剤などのノニオン系、アニオン系もしくは両性の耐熱性界面活性剤処理するなどの表面処理をしたものを使用するのが好ましい。これらの表面処理の中でも、特に両性のフッ素系界面活性剤処理を施したもののが好ましく使用される。本発明において、該紙状シートの表面において、該フッ素樹脂系纖維そのものが融着して、平滑化および緻密化を実現しているものである。すなわち、該フッ素樹脂系纖維がバインダー的機能を果たしているものである。

【0013】つぎに、本発明の紙状シートに用いる耐熱性エンジニアリングプラスチック纖維としては、180℃、10日で熱処理した後の引っ張り強度の保持率が95%以上である纖維であることが好ましい。

【0014】また纖維を構成するポリマーとしては、全芳香族ポリアミド、ポリフェニレンサルファイド、ポリエーテルエーテルケトン、ポリエーテルスルホン、ポリエーテルイミドおよび全芳香族ポリエステル（ポリアリレート纖維）などを使用することができる。かかる纖維は、一種或いは二種以上併用することができるが、これらの中でも誘電率が低く、耐熱性に優れた全芳香族ポリエステル纖維（ポリアリレート纖維）が好ましく使用される。

【0015】また、耐熱性エンジニアリングプラスチック

ク纖維は、引張強度の高い紙状シートを得るために、 10 g/d 以上の纖維強度を有する纖維で、さらに纖維長が $0.1 \sim 1.0\text{ cm}$ の範囲のものを使用するのが好ましい。

【0016】本発明の紙状シートを構成する、フッ素樹脂系纖維と耐熱性エンジニアリングプラスチック纖維の混用比（重量比）は、好ましくは $10 : 90$ を越え、 $80 : 20$ 以下とすのがよく、これを該フッ素樹脂系纖維の含有量でいうならば、好ましくは 10 重量\% を越えて 80 重量\% 以下、さらに好ましくは $40 \sim 70\text{ 重量\%}$ 、さらには $50 \sim 70\text{ 重量\%}$ の範囲内で使用するのが、引張強度の高い紙状シートを得るためによい。フッ素樹脂系纖維の重量比が多いとシート強力が不満足となり、低いと、接合力も小さく、かつ、樹脂含浸後の誘電率が不十分となる傾向がある。

【0017】本発明の紙状シートは、湿式不織布、つまり抄紙プロセスによって得ることができる。かかる紙状シートは、プリント配線基板を主たる用途とするものであり、この用途の場合、後加工として樹脂加工を施すものであり、この樹脂含浸後の誘電率を低く維持するものが好ましい。

【0018】本発明の紙状シートは、該フッ素樹脂系纖維によって融着されて平滑緻密化されているが、その程度は、プリント配線基板を作るときのプリント性、つまり絵際の鮮明性の上から、該平滑面に斜光を当てたときに、好ましくは少なくとも 60 \% 、さらに好ましくは少なくとも 70 \% の光を反射する平滑性を有するものがよい。

【0019】また、本発明の紙状シートは、該フッ素樹脂系纖維と耐熱性エンジニアリングプラスチック纖維が、均一に分散されているものが、易滑製の上からも好ましく、たとえば野村商事株式会社製フォーメーションテスターFMT-2000（光透過型斑測定機）により、測定したときに地合指数が、好ましくは 100 以下、さらに好ましくは 90 以下を示すものが、優れた纖維分散性を示すものであり、かかる紙状シートが平滑性にもすぐれており、高い値のものは誘電率も高くなつて好ましくないことを意味するものである。

【0020】本発明の紙状シートは、好ましくは 0.9 kg/1.5 mm 以上、さらに好ましくは 1.0 kg/1.5 mm 以上の強力と有するものがよい。すなわち、強力が小さい場合には、プリント配線基板を製造する際の樹脂加工の工程張力に耐えきれずシート切れを起こす場合がある。

【0021】本発明の紙状シートをプリント配線基板を製造する場合、用途により使用する紙状シートの枚数は異なるが、通常、複数の紙状シートを積層する。このとき、寸法安定性、均整性の面から該紙状シート1枚の厚さは、好ましくは $50\text{ }\mu\text{m}$ 以下のものを使用する。また、かかる紙状シートの目付は、好ましく $30 \sim 100\text{ g/m}^2$ 、さらに $20 \sim 60\text{ g/m}^2$ 、より好ましくは

$30 \sim 50\text{ g/m}^2$ であるものが使用される。

【0022】本発明では、低厚み（薄い）で高強力のシートを得るために、上記した耐熱性エンジニアリングプラスチック纖維およびフッ素樹脂からなる混抄紙（不織布）の少なくとも一部の纖維を熱圧着（融着）させておくのが好ましい。かかる融着方法としては、軟化点以上の温度で融点以下の温度、好ましくは約 $150 \sim 250^\circ\text{C}$ 、さらに好ましくは $180 \sim 220^\circ\text{C}$ で、圧力 $5 \sim 50\text{ kg/cm}^2$ の範囲の条件がよい。

10 【0023】かかる紙状シートは、低通気性であるものが水分の影響が少なくて好ましく、特にJIS L-1096の6.27.1-A法で測定したときに、好ましくは $30\text{ cc/cm}^2/\text{sec.}$ 以下、さらに好ましくは $25\text{ cc/cm}^2/\text{sec.}$ 以下という低通気度を有するシートであるものが、プリント配線基板としてときの耐久性に優れていてよい。

【0024】

【実施例】以下、実施例によって本発明をさらに具体的に説明する。

【0025】実施例1

20 開纖率 95% 、平均纖維長 6 mm 、平均纖度 6.7 デニール の表面がパーフルオロアルキルベタイン型両性界面活性剤S-131（旭硝子株式会社製）で処理されたPTFE纖維（東レ・ファインケミカル株式会社製フッ素纖維）と平均纖維長 5 mm 、平均纖度 2.5 デニール 、引張強度 12 g/d の全芳香族ポリエステル纖維とを重量比 $50 : 50$ で混合し、これを家庭用ミキサー（水 1200 ml ）により攪拌分散した。この後、漉いてシート化し乾燥して混抄紙を得た。この混抄紙を、ステンレススチール性ロールの表面にペーパーを巻いたカレンダーによりロール温度 200°C 、圧力 20 kg/cm^2 の条件で加熱加圧処理を行い、目付 39 g/m^2 の紙状シートを製造した。

30 このシートの野村商事株式会社製フォーメーションテスターFMT-2000（光透過型斑測定機）により、測定したときの地合指数は 88 であった。この紙状シートの他の物性を表1に示した。

【0026】また、このシートを樹脂含浸させたものの誘電率も表1に示す通り低誘電率であった。この紙状シートは厚みが薄く、強力を必要とするプリント配線基板用シートとして有用なものであった。

【0027】実施例2

PTFE纖維と全芳香族ポリエステル纖維の重量比を、 $60 : 40$ に変更した他は、実施例1と同一方法、同一条件を採用することにより得られたシートを、実施例1で用いたのと同一のロールで、ロール温度 220°C 、圧力 30 kg/cm^2 として熱圧着を行い、目付 47 g/m^2 の紙状シートを得た。この紙状シートの物性を表1に併せて示した。

【0028】このシートを樹脂含浸させたものの誘電率も表1に併せて示した。この紙状シートも厚みが薄く、地合指数も 76 で、強力を必要とするプリント配線基板

用シートとして有用なものであった。

【0029】実施例3

PTFE繊維と全芳香族ポリエステル繊維の重量比を50:50に変更した他は、実施例1と同一方法、同一条件を採用することにより得られたシートを、実施例1で用いたのと同一のロールで、ロール温度180°C、圧力2.5 kg/cm²として、表裏を反転させ2回通しを行い、目付4.5 g/m²の緻密な紙状シートを得た。得られた紙状シートの物性は表1に併せて示した。このシートを樹脂含浸させたものの誘電率を表1に示した。この紙状シートもまた厚みが薄く、地合指数も8.3で、強力を必要とするプリント配線基板用シートとして有用なものであった。

【0030】実施例4

開纖率9.5%、平均纖維長6mm、平均纖度6.7デニールの表面がフッ素系界面活性剤で処理されていないPTFE繊維（東レ・ファインケミカル株式会社製フッ素繊維）と実施例1で用いたのと同一の全芳香族ポリエステル繊維とを重量比70:30で混合した他は、実施例1と同一方法、同一条件で攪拌分散、熱圧着を行い、目付4.5 g/m²の紙状シートを得た。このシートの地合指数は9.2で、その他の物性及びこのシートを樹脂含浸させた

誘電率を表1に示した。

【0031】実施例5

PTFE繊維と全芳香族ポリエステル繊維の重量比を15:85に変更した他は、実施例1と同一方法、同一条件を採用することにより目付4.3 g/m²の紙状シートを得た。得られたシートの地合指数は9.6で、その他の物性及びこのシートを樹脂含浸させた誘電率を表1に示した。

【0032】比較例1

10 平均纖維長6mm、平均纖度6.0デニールのガラス繊維と平均纖維長5mm、平均纖度2.5デニール、引張強度1.2 g/dの全芳香族ポリエステル繊維とを重量比50:50で混合し、その他は実施例1と全く同一条件を採用することにより、目付4.0 g/m²の紙状シートを得た。そのシートの地合指数は8.9で、その他の物性およびこのシートを樹脂含浸させたものの誘電率を表1に示した。表1に示したとおり、誘電率が高く、また、ガラス繊維の融着がないため強度が劣りプリント配線基板用への適用は不可能であった。

【0033】

【表1】

表1

	実施例1	実施例2	実施例3	実施例4	実施例5	比較例1	比較例2	測定方法
目付 (g/m ²)	39.0	47.0	45.0	45.0	43.0	40.0	50.0	JIS P-8124
厚み (μm)	40.6	48.4	49.8	41.8	41.0	40.5	49.7	JIS P-8118
強力 (kg/15mm)	1.10	1.20	1.32	0.92	1.54	0.24	0.04	JIS P-8113
誘電率 (1MHz)	2.80	2.66	2.80	2.48	3.29	4.30	—	JIS C-5012
透気度 (cc/cm ² /sec)	25	15	20	22	23	41	53	JIS L-1096

【0034】比較例2 PTFE繊維と全芳香族ポリエステル繊維の重量比を60:40に変更した他は、実施例1と同一方法、同一条件で攪拌分散し、その後漉いてシート化し乾燥して目付5.0 g/m²の紙状シートを得た。そのシートの地合指数は9.2で、その他の物性を表1に示した。この紙状シートは加熱加圧処理されていないため、PTFE繊維の融着がない。したがって、紙状シートの表面が平面緻密化されず、また強力が低いものとな

り樹脂含浸ができなかった。

【0035】

【発明の効果】従来、フッ素繊維の本質的な特性から地合に優れた、低厚み、高強度のシートを得ることは困難とされていたが、本発明によれば、フッ素繊維の耐熱性、誘電特性等の優れた機能をそのままに、薄く高強度のシートが得られ、誘電特性に優れたプリント配線基板用等に最適なものを提供することができる。

フロントページの続き

(72)発明者 三吉 威彦

滋賀県大津市大江1丁目1番1号 東レ株
式会社瀬田工場内

(72)発明者 富田 忠

大阪市北区中之島3丁目3番3号 東レ
ファインケミカル株式会社大阪支店内